公司代码:600460　　公司简称:士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司

2014 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	士兰微	600460	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈越	马良
电话	0571-88210880	0571-88212980
传真	0571-88210763	0571-88210763
电子信箱	600460@silan.com.cn	ml@silan.com.cn

二　主要财务数据和股东情况

2.1　公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	4,018,156,119.20	4,133,866,576.82	-2.80	3,350,408,146.52
归属于上市公司股东的净资产	2,398,724,432.19	2,257,460,987.34	6.26	1,696,892,031.27
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	267,189,510.46	202,934,742.27	31.66	168,159,848.74
营业收入	1,870,029,299.81	1,637,934,274.17	14.17	1,349,024,202.50
归属于上市公司股东的净利润	164,344,173.76	115,267,665.62	42.58	18,273,006.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,203,317.86	35,394,636.27	166.15	-47,469,931.67
加权平均净资产收益率(%)	7.06	6.05	增加1.01个百分点	1.08
基本每股收益(元/股)	0.13	0.10	30.00	0.015
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.10	30.00	0.015

2.2　截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	62,519
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	52,766

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
杭州士兰控股有限公司	境内非国有法人	42.72	532,841,590	0	质押	52,150,000
中国银行股份有限公司-长盛电子信息产业股票型证券投资基金	未知	1.38	17,181,950	0	未知	
陈向东	境内自然人	1.28	16,005,096	0	无	
范伟宏	境内自然人	1.10	13,723,866	0	无	
郑少波	境内自然人	0.90	11,164,553	0	无	
江忠永	境内自然人	0.87	10,790,000	0	无	
全国社保基金四一八组合	未知	0.80	10,000,000	0	未知	
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	未知	0.73	9,135,346	0	未知	
全国社保基金一一零组合	未知	0.64	8,030,920	0	未知	
罗华兵	境内自然人	0.56	6,935,646	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,在册持有本公司股份前十名无限售条件股东中的陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵等五人为本公司第一大股东杭州士兰控股有限公司股东。其他持有无限售条件股东未知是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3　截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

本报告期公司无优先股事项。

2.4　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三、　管理层讨论与分析

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年,公司各项主要业务继续保持稳定向的趋势,经营业绩得到进一步提升。2014年,公司营业总收入为187,003万元,较2013年增长14.17%;公司营业利润为11,767万元,比2013年增加82.89%;公司利润总额为18,502万元,比2013年增加48.83%;公司归属于母公司股东的净利润为16,434万元,比2013年增加42.58%。

2014年,公司集成电路的营业收入较去年同期增长15.15%。公司集成电路业务重新回到上升通道,是公司长期来坚持IDM(设计制造一体化)模式,坚持差异化、品牌化发展战略的结果。2014年,公司集成电路营业收入的增长的主要来自LED照明驱动电路出货量的快速增长。2014年,公司已经开发出三轴加速度传感器、三轴地磁传感器等MEMS产品,并开始批量生产,陀螺等其它MEMS传感器产品已在进行工程样片的测试。2014年,公司还开发出符合"能源之星6级能效标准"的AC-DC驱动电路,高清安防监控芯片等新产品。2014年,公司在IPM(智能功率模块)、IGBT等功率产品的推广上继续取得进展。今后,随着新产品的陆续上量,公司集成电路的销售额将继续保持增长。

2014年,公司分立器件芯片营业收入较去年同期减少9.70%,功率器件成品的营业收入较去年同期增长18.31%。分立器件芯片营业收入较去年同期下降的主要原因是:部分器件芯片产品的市场竞争加剧,导致价格下降,丢失部分市场。未来随着IGBT等新产品的上量,公司功率器件成品的营业收入将进一步提高。

2014年,公司子公司士兰集成公司在成本控制、质量提升、交期改善、安全生产等方面进一步取得进展,芯片总产量达到180万片,比去年同期增加11.40%;公司子公司成都士兰公司的硅外延车间已投入试生产,实现自产外延片收入4,952万元,这对于推进"成都士兰一期工程项目"创造了有利条件。2014年下半年,公司已在成都开展功率模块和功率器件成品的封装业务,并在2014年年底实现了工程试验批的产出。

2014年,公司LED芯片和成品的营业收入分别较去年同期增长44.73%和113.46%,LED芯片和成品的毛利率分别较去年同期上升20.76个百分点和10.02个百分点,公司子公司士兰明芯公司和美卡乐公司均已实现扭亏为盈。2014年,士兰明芯已经成功开发出LED照明用高压芯片,并已经推向市场。2014年,随着产能的释放,美卡乐公司在高端彩屏像素器件市场的竞争优势得到巩固,品牌形象进一步提升。截至2014年年底,士兰明芯公司新建的LED生产厂房已结顶,2015年上半年将完成净化装修,并进一步扩充LED芯片产能。

2014年,公司通过强化资金管理,在进一步拓宽融资渠道的同时,有效减少了财务费用。2014年,公司向投资者偿付了4.84亿元公司债券本金,进一步降低了公司资产负债率。

2014年,公司及子公司共获得专利授权128项,集成电路布图设计授权211项。截至2014年年底,公司及子公司已累计获得各种权利证书511项。

2014年,在举世瞩目的APEC之夜,鸟巢LED灯幕(宽度2 3 2米,上下高度为5 5米)采用了士兰微电子创新的LED屏控制/驱动电路和方案,这是公司长期来坚持技术创新的又一有力展现。今后,公司将继续坚持走设计与制造一体的模式,在半导体功率器件、MEMS传感器、LED等多个技术领域持续进行生产资源、研发资源的投入;利用公司在多个芯片设计领域的积累,提供针对的芯片产品和系统应用解决方案;不断提升产品质量和口碑,提升产品附加值。

(二)　主营业务分析

1　利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,870,029,299.81	1,637,934,274.17	14.17
营业成本	1,319,192,579.06	1,211,738,232.16	8.87
销售费用	48,525,500.35	40,859,280.65	18.76
管理费用	358,544,217.49	296,952,337.39	20.74
财务费用	42,338,002.41	64,085,265.15	-33.93
经营活动产生的现金流量净额	267,189,510.46	202,934,742.27	31.66
投资活动产生的现金流量净额	-71,878,128.83	-341,012,251.25	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-379,365,811.72	366,398,714.91	不适用
研发支出	197,364,562.45	163,452,508.32	20.75

2　收入

(1)　驱动业务收入变化的因素分析

2014年,公司营业收入较2013年上升了14.17%,公司营业收入增加的主要原因是:随着公司新产品上量进度加快,公司集成电路、功率器件成品、发光二极管芯片、发光二极管成品的营业收入均较去年同期有所增加,其中LED照明驱动电路、发光二极管芯片和发光二极管成品的营业收入增长较快。

(2)　以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2014年,公司子公司士兰集成生产集成电路和分立器件芯片180万片,比2013年增加11.40%;公司子公司士兰明芯生产发光二极管芯片30,582 KK(百万颗),比2013年增加83.50%。

(3)　主要销售客户的情况

公司向前5名客户销售合计为39,079.20万元,占公司营业收入的20.90%。

公司的前五名客户分别是:杭州友旺电子有限公司,EXAR CORPORATION,Cheng Du Advanced Power Semiconductor CO.,LTD,深圳市润诺实业有限公司,KEC Corporation。

3　成本

(1)　成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
电子元器件	?	1,314,946,331.97	100	1,209,751,380.83	100	8.70	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
集成电路	?	443,758,169.44	33.75	404,885,614.11	33.47	9.60	
器件成品	?	251,723,146.98	19.14	201,414,360.86	16.65	24.98	
器件芯片	?	334,294,142.32	25.42	383,453,456.40	31.70	-12.82	
发光二极管芯片	?	193,109,199.56	14.69	169,749,222.40	14.03	13.76	
发光二极管成品	?	91,438,760.29	6.95	49,374,025.68	4.08	85.20	
其他	?	622,913.39	0.05	874,701.38	0.07	-28.79	

关于成本项的说明:

1)集成电路和分立器件芯片制造成本构成

项目	2014年	2013年
主材	31.89%	30.04%
辅材	20.59%	21.17%
人工	18.59%	18.02%
制造费用	28.93%	30.77%
合计	100.00%	100.00%

2)发光二极管管芯片制造成本构成

项目	2014年	2013年
主材	14.27%	12.18%
辅材	26.47%	24.56%
人工	11.05%	10.74%
制造费用	48.21%	52.51%
合计	100.00%	100.00%

(2)　主要供应商情况

公司向前五名供应商合计的采购金额为27,751.23万元,占报告期采购总额的24.45%。

公司的前五名供应商分别是天水华天科技股份有限公司,河北普兴电子科技股份有限公司,上海合晶硅材料有限公司,南通富士通微电子股份有限公司,浙江金瑞泓科技股份有限公司。

4　费用

单位:元

利润表项目	2014年	2013年	变动幅度(%)	变动原因
财务费用	42,338,002.41	64,085,265.15	-33.93	主要系本期已偿付部分债券本金相应计提的利息支出减少所致。
公允价值变动收益	-6,106,338.24	2,461,616.46	-348.06	主要系士兰集成因黄金租赁形成的交易性金融负债的公允价值变动所致。
投资收益	52,031,704.70	72,948,397.72	-28.67	主要系本期没有处置可供出售金融资产取得的投资收益。
营业外支出	4,600,552.92	6,866,668.45	-33.00	主要系本期减少资产处理损失所致。
所得税费用	17,955,608.98	6,202,553.50	189.49	主要系本期营业利润增加所致。

5　研发支出

(1)　研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	197,364,562.45
本期资本化研发支出	
研发支出合计	197,364,562.45
研发支出总额占净资产比例(%)	8.17
研发支出总额占营业收入比例(%)	10.55

(2)　情况说明

作为国内半导体领域中以IDM(设计与制造一体化)为主要模式的公司,研发支出主要分为设计研发和制造工艺研发。公司的目标是成为国内领先的自有品牌的半导体产品供应商。围绕这个长期的目标,报告期内,研发项目仍主要围绕电源管理产品平台、功率半导体器件与模块技术、数字音视频技术、射频/模拟技术、MCU/DSP产品平台、MEMS传感器产品与工艺技术平台、发光二极管制造及封装技术平台等几大方面进行。通过这些研发活动,公司不断丰富现有的产品群,譬如推出IGBT等功率器件和功率模块产品,推出LED电源电路、数字音视频电路、MCU电路、MEMS传感器等产品,推出高品质的LED芯片和成品。

6　现金流

单位:元

现金流量表项目	2014年	2013年	变动幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	267,189,510.46	202,934,742.27	31.66	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金及收到的税费返还增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-71,878,128.83	-341,012,251.25	-78.92	主要系本期因理财产品到期收回的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-379,365,811.72	366,398,714.91	不适用	主要系本期偿付公司债券本金4.84亿元。

(三)　行业、产品或地区经营情况分析

1、　主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电子元器件	1,859,692,553.54	1,314,946,331.97	29.29	14.43	8.70	增加3.73个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
集成电路	677,917,783.77	443,758,169.44	34.54	15.15	9.60	增加3.32个百分点
器件成品	308,127,700.14	251,723,146.98	18.31	17.25	24.98	减少5.05个百分点
器件芯片	479,137,643.50	334,294,142.32	30.23	-9.70	-12.82	增加2.50个百分点
发光二极管芯片	253,241,608.98	193,109,199.56	23.75	44.73	13.76	增加20.76个百分点
发光二极管成品	139,324,898.71	91,438,760.29	34.37	113.46	85.20	增加10.02个百分点
其他	1,942,918.44	622,913.39	67.94	-30.99	-28.79	减少0.99个百分点

2、　主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
浙江	1,859,692,553.54	14.43

(四)资产、负债情况分析

1　资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	487,328,505.87	12.13	739,424,988.89	17.89	-34.09
存货	664,671,927.92	16.54	514,625,203.83	12.45	29.16
其他流动资产	326,429,268.80	8.12	450,016,035.29	10.89	-27.46
长期待摊费用	11,524,082.59	0.29	16,740,309.37	0.40	-31.16
其他非流动资产	3,585,815.48	0.09	14,290,168.66	0.35	-74.91
短期借款	525,000,000.00	13.07	405,516,637.00	9.81	29.46
应付账款	298,667,761.99	7.43	237,735,990.71	5.75	25.63
应付利息	9,719,057.54	0.24	19,432,682.81	0.47	-49.99
一年内到期的非流动负债	17,977,745.43	0.45	48,994,685.40	1.19	-63.31
应付债券	114,869,678.95	2.86	598,326,734.48	14.47	-80.80
长期应付款	18,502,764.12	0.46	32,113,083.52	0.78	-42.38
递延收益	227,450,103.20	5.66	169,765,626.29	4.11	33.98
递延所得税负债	102,238.41	0.00	667,987.75	0.02	-84.69
股本	1,247,168,000.00	31.04	959,360,000.00	23.21	30.00
资本公积	170,920,045.72	4.25	458,728,045.72	11.10	-62.74
其他综合收益	14,112,213.93	0.35	37,192,942.84	0.90	-62.06

情况说明:

货币资金项目期末数较期初数减少34.09%(绝对数减少25,209.65万元),主要系偿还到期债券所致。

存货项目期末数较期初数增加29.16%(绝对数增加115,004.67万元),主要系随着公司芯片技改项目、产能提升项目、LED芯片生产线扩产项目等逐步投产,公司加大了生产投入和产成品储备所致。

其他流动资产期末数较期初数减少27.46%(绝对数减少12,358.68万元),主要系上年度购买的理财产品到期收回所致。

长期待摊费用项目期末数较期初数减少31.16%(绝对数减少521.62万元),主要系费用摊销所致。

其他非流动资产项目期末数较期初数减少74.91%(绝对数减少1,070.44万),主要系融资租赁未实现售后租回损益摊销所致。

短期借款项目期末数较期初数增加29.46%(绝对数增加111,948.34万元),主要系本期产销规模扩大适度增加短期借款所致。

应付账款项目期末数较期初数增加25.63%(绝对数增加6,093.18万元),主要系公司本期产销规模扩大,相应采购增加所致。

应付利息项目期末数较期初数减少49.99%(绝对额减少971.36万元),主要系上年末计提的债券利息本期已支付所致。

一年内到期的非流动负债项目期末数较期初数减少63.31%(绝对额减少3,101.69万元),主要系士兰集成公司售后租回融资租赁业务将于一年内支付的租赁款减少所致。

应付债券项目期末数较期初数减少80.80%(绝对额减少48,345.71万元),主要系本期已偿付部分债券本金所致。

长期应付款项目期末数较期初数减少42.38%(绝对额减少1,361.03万元),主要系士兰集成公司本期支付售后租回融资租赁,以及将未来一年需支付的租赁款转入一年内到期的非流动负债所致。

递延收益项目期末数较期初数增加33.98%(绝对额增加5,768.45万元),主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致。

递延所得税负债项目期末数较期初数减少84.69%(绝对额减少565.57万元),主要系本期应纳税暂时性差异减少所致。

股本项目期末数较期初数增加30%(绝对额增加28,780.80万元),主要系本期资本公积转增股本所致。

资本公积项目期末数较期初数减少62.74%(绝对额减少28,780.80万元),主要系本期资本公积转增股本所致。

其他综合收益项目期末数较期初数减少62.06%(绝对额减少2,308.07万元),主要系联营企业友旺电子公司出售可供出售的金融资产所致。

2　公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

项　目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,194,225.00	-512,635.60			681,589.40
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	1,194,225.00	-512,635.60			681,589.40
金融负债	144,140,973.29	-5,593,702.64			152,677,375.93

(五)核心竞争力分析

1.较为成熟的IDM模式

公司从集成电路芯片设计业务开始,逐步搭建了芯片制造平台,并已将技术和产品链延伸至功率器件、功率模块和MEMS传感器核心技术的研发领域,建立了较为成熟的IDM(设计与制造一体)经营模式。IDM模式可有效进行产业链内部整合,公司设计研发和工艺制造平台同时发展,形成了特殊工艺技术与产品研发的紧密互动,以及器件、集成电路和模块产品的协同发展。公司依托IDM模式形成的设计与工艺相结合的综合实力,提升产品品质、加强控制成本,向客户提供差异化的产品与服务,提高了其向大型厂商配套体系渗透的能力。

2.产品群协同效应

公司从IC设计企业完成了向综合性的半导体产品供应商的转变,在半导体大框架下,形成了功率器件、功率模块、集成电路、MEMS传感器、LED业务的协同发展,各业务之间相互补充、促进、群鲤。公司在产品销售时,可根据客户需求,给出满足客户需求的产品、组合和方案。比如进入LED业务之后,公司在集成电路业务中积累的技术、人才资源和管理经验,成为LED业务发展的后盾;再比如公司结合LED芯片和集成电路这两个领域较为深入的技术理解和积累,经过持续的研发,近期推出了创新的、高性能指标的大型LED彩屏驱动系统和电路,得到了高端彩屏厂家的认可。

3.较为完善的技术研发体系

公司已经建立了可持续发展的产品和技术研发体系。LED电源驱动电路、各类AC-DC电源电路、高性能指标的大型LED彩屏驱动系统和电路、MEMS传感器产品、以IGBT为代表的功率半导体产品、高压集成电路和智能功率模块产品、美卡乐高可靠性指标的LED彩屏像素管等新技术产品都是公司近几年在这个技术研发体系中依靠自身的高强度投入和积累完成的。

公司的研发工作主要可分为两个部分:芯片设计研发与工艺技术研发。在芯片设计研发方面,公司以IPD(集成产品开发管理体系)为引导,依照产品的技术特征,将技术研发工作根据各产品线进行划分。目前主要分为电源与功率驱动产品线、MCU产品线、数字音视频产品线、物联网产品线、射频与混合信号产品线、分立器件产品线等。公司持续推动新产品开发和产业化,根据市场变化不断进行产品升级和业务转型,保持了持续发展能力。

在工艺技术平台研发方面,公司依托于士兰集成业已稳定运行的芯片生产线,建立了新产品和新工艺技术研发团队,陆续完成了国内领先的高压BCD工艺平台、槽栅IGBT工艺平台、超薄片工艺平台、MEMS传感器工艺平台等,形成了有特色的特殊工艺制造平台。这一方面保证了公司产品种类的多样性,另一方面也支撑了公司工艺平台的不断进步和技术水平的提升。

在LED芯片技术和封装技术领域,公司也建立了完整的研发团队和技术开发体系,投入了大量的技术研发力量,攻克了LED芯片的ESD防护、图形化衬底、金属淀积质量、MOCVD外延参数均匀性、美卡乐LED封装品的可靠性、产品参数一致性等一系列技术关口,在提升产品品质的同时,有效地降低了生产成本。

4.面向全球品牌客户的品质控制

公司建立了完整的质量保障体系,依托产品研发和工艺技术的综合实力提升和保证产品品质。目前公司已经获得了ISO/TS16949质量管理体系、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证、索尼GP认证、欧盟ROSH认证、ECO认证等诸多国际认证,产品已经得到了欧司朗、三星、LG、泰尼、达科、巴可等全球品牌客户的认可。公司设计研发、芯片制造、测试系统的综合实力,保证了产品品质的优良和稳定,是公司参与市场竞争、开发高端市场、开发高品质大客户的保障。

4、　优秀的人才队伍

公司已拥有一支超过350人的集成电路芯片设计研发队伍,超过500人的芯片工艺、封装技术、测试技术研发队伍。公司还建立了较为有效的技术研发管理和激励制度,保证人才队伍的稳定,为公司在竞争激烈的半导体行业中保持持续的技术研发能力和技术优势奠定了基础。

(六)公司发展战略

公司发展目标和战略:成为国内领先的、有自主品牌的半导体产品供应商;走设计与制造一体的模式,在半导体功率器件、MEMS传感器、LED等多个技术领域持续进行生产资源、研发资源的投入;利用公司在多个芯片设计领域的积累,提供针对性的芯片产品和系统应用解决方案;不断提升产品质量和口碑,提升产品附加值。

具体描述如下:

▲利用在控制芯片和功率器件的技术和成本上的优势,在LED照明驱动领域全力拓展,抓住该市场快速放大的时机,积极拓展高端品牌客户,提高市场占有率。同时将加快智能照明系统的芯片和应用方案开发。

▲在高压BCD工艺、高压半导体功率器件和模块的技术研发上加大投入,拓展和丰富以IGBT为代表的功率器件产品和智能功率模块产品,拓展这些产品在新能源、高效电机驱动、工业控制等领域的应用。

▲持续推进士兰"美卡乐"高端LED成品品牌的建设,积极拓展海内外高端客户,扩充产能,拓展新的高端应用市场。

▲加快推进MEMS传感器的市场开拓步伐,在三轴加速度传感器、三轴磁传感器推向市场之后,将陆续推出三轴陀螺仪和空气压力传感器等MEMS传感器产品,进上移动智能终端、穿戴式设备和物联网等产品的发展步伐。

▲整合公司各产品线的技术优势(功率驱动、无线射频、MCU/DSP控制),在智能照明、变频电机控制、大型彩屏控制系统等领域推出完整应用方案和配套电路。

▲继续在数字音视频(含安防监控)领域投入,巩固并拓展应用市场。

▲持续在LED芯片领域投入,在LED彩屏芯片已取得较好优势的产业基础上,加快发展照明LED芯片业务。

▲继续全力推动特殊工艺研发、制造平台的发展,规划建设一条8英吋集成电路芯片生产线,在特殊工艺领域坚持走IDM(设计与制造一体)的模式。继续推进成都半导体生产基地的建设,逐步实现投产。

(七)经营计划

1.公司的产品线规划

2015年公司产品线将按七个方面进行规划、管理和运行:电源和功率驱动产品线、数字音视频产品线、物联网产品线、MCU产品线、混合信号与射频产品线、分立器件产品线、LED器件产品线等。

2.对2015年营业总收入的预计

2014年,公司实现营业总收入18.70亿元,完成收入计划的93.50%。预计2015年实现营业总收入22.5亿元左右(比2014年增长20%左右),营业总成本将控制在20.5亿元左右。

上述预计不构成对本公司的盈利预测,其实现具有不确定性,提请投资者注意投资风险。

(八)巩固持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

12015年公司资本支出计划

(1)成都士兰一期工程项目:该项目总投资为99,995万元,截至2014年年底,已完成项目进度的50%。2015年,公司将继续稳步推进该项目建设,以进一步提升效益。该项目资金来源为募集资金和企业自筹。

(2)士兰集成产能提升项目:该项目总投资为15,000万元,截至2014年年底,已完成项目进度的45%。2015年将完成剩余部分投资,以进一步挖掘芯片生产线产能,提升效益。该项目资金来源为企业自筹。

(3)士兰明芯LED生产厂房扩建项目:该项目总投资为7,500万元,截至2014年年底,士兰明芯已完成该项目投资2,312.17万元,项目进度30%。2015年将完成剩余部分投资。该项目资金来源为企业自筹。

(4)士兰明芯11-14万片中后道扩产项目:该项目总投资为8,000万元,截至2014年年底,士兰明芯已完成该项目投资602.00万元,项目进度10%。2015年将完成剩余部分投资,以进一步提升LED芯片生产线产能、提升效益。该项目资金来源为企业自筹。

2.2015年公司研发支出计划

2014年,公司研发支出总计约为1.97亿元,约占年度计划的115.88%。预计2015年公司研发支出为2.25亿元。

3.2015年公司借贷计划

2014年,公司已向债券投资人偿付公司债券本金4.84亿元,为此,公司已适度增加银行借贷规模。2015年,公司将进一步拓宽融资渠道,根据2015年生产经营计划和投资计划适度增加借贷规模;同时,将通过进一步改善经营活动,降低对流动资金的占用,控制资产负债率。

(九)可能面对的风险

1.宏观风险及其对策

半导体行业受宏观经济形势波动影响较大,前些年发生的全球性金融危机,欧债危机等都对半导体行业产生了较大影响。目前全球经济增长出现了明显的分化。一方面,美国经济形势呈现加速向好的迹象,美联储已停止实施量化宽松政策,并有可能在2015年二、三季度开始加息。另一方面,欧元区国家、日本等发达经济体的经济增长出现停滞或技术性衰退,欧洲央行和日本央行均加大了量化宽松政策的力度;同时,经济发达国家实施的超宽松货币政策所带来的货币溢出效应也对新兴国家形成了冲击,由于自身及外部因素,金砖国家为代表的新兴经济体的经济增速已明显放缓。2015年,随着美联储加息脚步的日益临近,我们要特别关注美元大幅升值可能对全球金融市场带来的冲击,对于宏观风险,公司将加快资源整合和技术创新、进一步提高资产营运的效率;将进一步拓宽融资渠道、把握好资本运用的节奏,降低债务杠杆。

2.行业周期风险及其对策

半导体行业存在明显的行业周期。近年来,随着技术发展和应用领域更新加速,行业周期呈现缩短趋势。对于行业周期风险,公司将抓住国家大力支持国内集成电路产业发展的有利时机,坚持开完善IDM发展模式,通过加大对产品、技术研发投入,加强市场推广和品牌建设,把握好固定资产投资节奏,从而实现可持续发展。

3.新产品开发风险及其对策

随着半导体消费终端产品市场更新频率的加快,公司产品创新的风险也在加大。如果公司的创新不能踏准市场需求的节奏,公司将浪费较大的资源,并丧失市场机会,不能为公司的发展提供新的动力。针对该类风险,公司将充分结合IDM模式(设计与制造一体化)的优势,加大对高端功率半导体芯片、MEMS器件和传感器等新产品的研发投入,加快推出契合市场的新产品,"持之以恒、做精做专",深挖细分市场空间。

四　涉及财务报告的相关事项

4.1　与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及影响。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年修订或新制定发布的《企业会计准则第9号——职工薪酬》等八项具体会计准则	本次变更经公司五届十八次董事会审议通过	详见下表说明

受重要影响的报表项目和金额	
受重要影响的报表项目	影响金额
2013年12月31日资产负债表项目	
可供出售金融资产	3,891,915.89
长期股权投资	-3,891,915.89
递延收益	169,765,626.29
其他非流动负债	-169,765,626.29
其他综合收益	37,192,942.84
资本公积	-37,192,942.84

4.2　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司将杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰明芯科技有限公司、杭州士兰光电技术有限公司、杭州士兰半导体制造有限公司、杭州士兰景电子有限公司、杭州博脉科技有限公司、杭州美卡乐光电有限公司、士藤科技有限公司、Silan Electronics,Ltd、成都士兰半导体制造有限公司、深圳市深兰微电子有限公司(以下分别简称士兰集成公司、士兰明芯公司、士兰光电公司、士景公司、博脉公司、美卡乐公司、士藤公司、士兰BVI公司、成都士兰公司、深兰微公司)10家子公司纳入本期合并财务报表范围,具体情况详见《2014年年度报告》本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

董事长:陈向东

杭州士兰微电子股份有限公司

2015年3月8日

证券代码:600460　　股票简称:士兰微　　编号:临2015-009

债券代码:122074　　债券简称:11士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●独立董事裴长洪先生因公未能亲自出席本次董事会,委托独立董事金小刚先生代为行使同意表决权,其余董事均亲自出席本次会议。

杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议于2015年3月8日在浙江省杭州市黄姑山路4号公司三楼大会议室召开。本次董事会已于2015年2月26日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员,并电话确认。会议应到董事11人,实到11人,其中独立董事裴长洪先生因参加政协会议而委托独立董事金小刚先生代为行使同意表决权,其余董事均亲自出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持,符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议以现场表决的方式通过了以下决议:

1、《2014年年度报告》及摘要

全文详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

2、《2014年度总经理工作报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

3、《2014年度董事会工作报告》

详细内容请见《2014年年度报告》之"董事会报告"部分。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

4、《2014年度财务决算报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

5、《2014年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度共实现归属于母公司股东的净利润164,344,173.76元;依据《公司法》和公司章程的规定,提取10%法定公积金16,374,454.53元后,当年可供股东分配的利润为147,969,719.23元。加上上年结转未分配利润697,043,505.57元,累计可供股东分配的利润为845,013,224.80元。

公司2014年度的利润分配的预案为:拟以2014年度末公司注册资本124,716.8万股为基数,每10股派发现金股利0.25元(含税),总计派发现金股利3,117.92万元。剩余813,834,024.80元转至以后年度分配。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过,并提请股东大会授权董事会办理现金分红相关事宜。

6、《2014年度关于公司内部控制的自我评估报告》;

全文详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

7、《2014年度社会责任报告》;

全文详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

8、《关于与友旺电子日常关联交易的议案》;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临 2015-011。

表决结果:关联董事陈向东、罗华兵回避表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

9、《关于与士腾科技日常关联交易的议案》;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临 2015-011。

因本议案所涉金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》10.2条规定,无需提交股东大会审议。

表决结果:关联董事陈向东、郑少波、范伟宏、江忠永、罗华兵回避表决,6票同意,0票反对,0票弃权。

10、《关于续聘2015年度审计机构并确定其报酬的议案》;

公司支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2014年度财务报告审计报酬共计83万元人民币。公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度财务报告进行内部控制审计机构,并确定2015年度财务报告审计报酬为83万元(